

FPGA・CPLD Socket

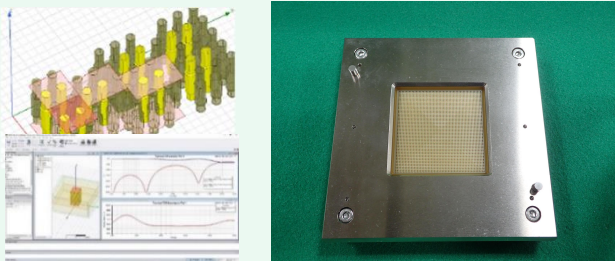
お客様の使用用途に応じ、最適なFPGA・CPLD用ソケットを提案・提供

特長

- ・プローブを用いたソルダーレスソケット
- ・接触性・耐久性・温度範囲にメリット
- ・製作は、1setから対応可
- ・放熱機構（ヒートシンク・ファン）の組込も可

XILINX-VERSAL, Intel-Agilex等の
高性能SoC・FPGAにおすすめ

マルチインピーダンスタイプ

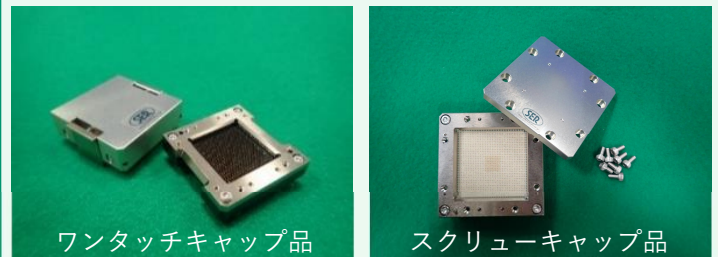


このような方へ

- ・複数の高速I/Oインターフェースを有する、高価なハイエンドFPGA・SoC FPGAを用いて検証・評価を行うにあたり、デバイスは使い回し出来る形にしたい。
- ・デバイスのパフォーマンスを最大限に活かすべく、ソケットの伝送路もインピーダンスマッチングを図った構造にしたい。

XILINX-VIRTEX, Intel-Stratixから
レガシーFPGAまで、幅広く対応

スタンダードタイプ



このような方へ

- ・リユースのために製品から取り外し、リボールを行ったFPGAの検査
- ・海外から仕入れたFPGAの受け入れ検査用にしたい。
- ・大量のFPGA/CPLDへデータの書き込みを行いたい。
- ・ソケットにかかる費用は、極力抑えたい。

お問合せの際は、
デバイスの型番とパッケージ図面の提供をお願いします。

We Solve Your Interconnect Challenges.



<https://www.ser.co.jp>

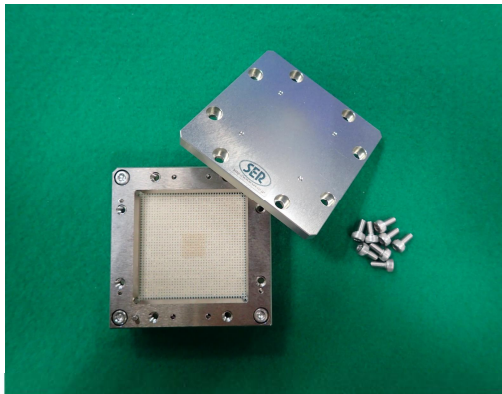
Tel:03-5796-0330
Email:ser@ser.co.jp

FPGA・CPLD Socket スタンダードタイプ

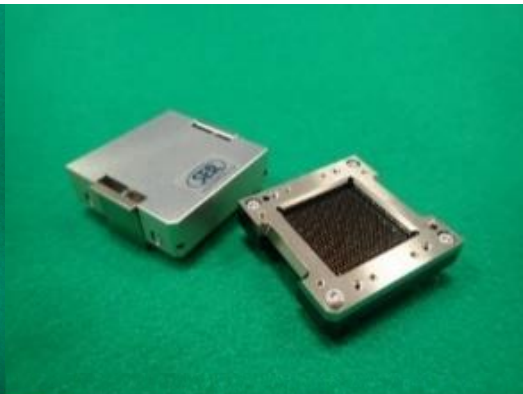
スタンダードタイプは、
スクリューキャップ品・ワンタッチキャップ品がベースとなりますが、
使用されるFPGA・CPLDや使用用途に応じて、

- ・ クラムシェルキャップ品／ハンドルキャップ品の提供
- ・ 放熱機構（ヒートシンク・ファン）を組込んだ形での提供も可能です。

ご要望がある際は、各営業担当者へご相談ください。



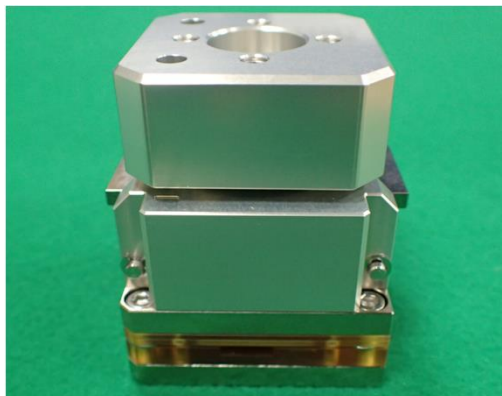
スクリューキャップ品



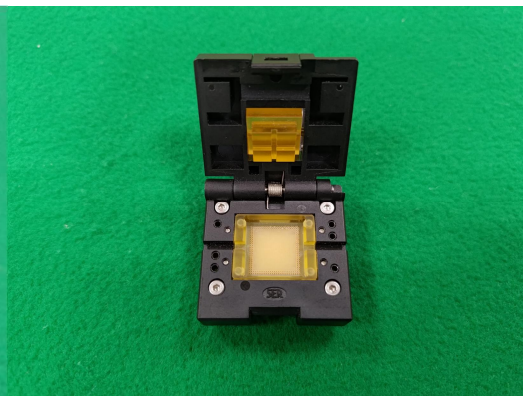
ワンタッチキャップ品



放熱機構を組込んだ一例
(キャップ+ヒートシンク+ファン)



ハンドルキャップ品



クラムシェルキャップ品



放熱機構を組込んだ一例
(スリットを設けたキャップ+ファン)

We Solve Your Interconnect Challenges.



<https://www.ser.co.jp>

Tel:03-5796-0330
Email:ser@ser.co.jp